重力波検出器の冷却技術の 高性能化

東大宇宙線研共同利用成果発表会

高工ネ研, 東大宇宙線研A

<u>都丸隆行</u>、鈴木敏一、佐藤伸明、春山富義、山本明、新冨孝和、 山元一広^A、内山隆^A、三代木伸二^A、大橋正健^A、黒田和明^A

H18年度宇宙線研共同利用研究の項目

- 1. CLIOクライオスタットの入熱解析
- 2. ヒートリンク部の接触熱抵抗の低減

1. CLIOクライオスタットの入熱解析

CLIOクライオスタットの仕様

Inner Shield: 8K以下、入熱量10mW以下

← 鏡の温度:20K

ところが・・・

初期冷却試験:12.6K、入熱量 > 3W

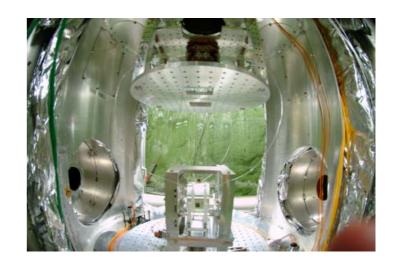
Ţ

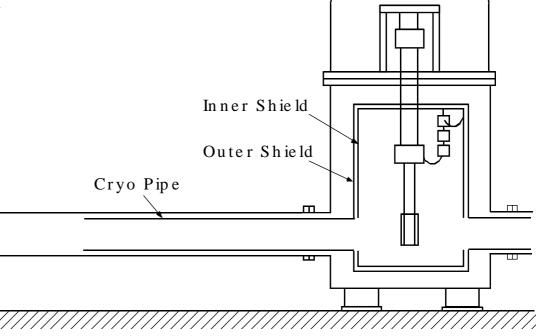
Cryo Pipeの開口を絞ることで

Inner Shield: 7.3 K

と仕様を充たすことが出来た。





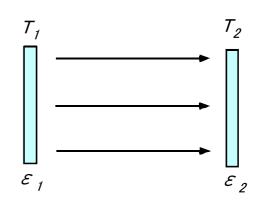


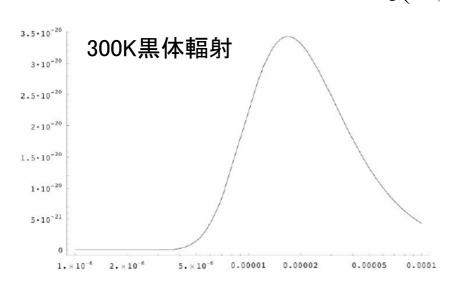
輻射による入熱と思われるが、メカニズムが不明。

一般的な輻射の計算
$$P = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_1 \varepsilon_2} \sigma \left(T_2^2 - T_1^2\right) A \frac{\Omega}{2\pi}$$

黒体輻射のスペクトラム

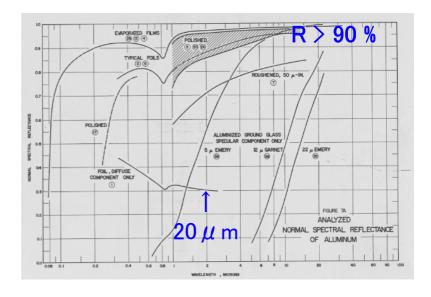
$$u(\omega) = \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^3}{\exp(\hbar \omega/kT) - 1}$$



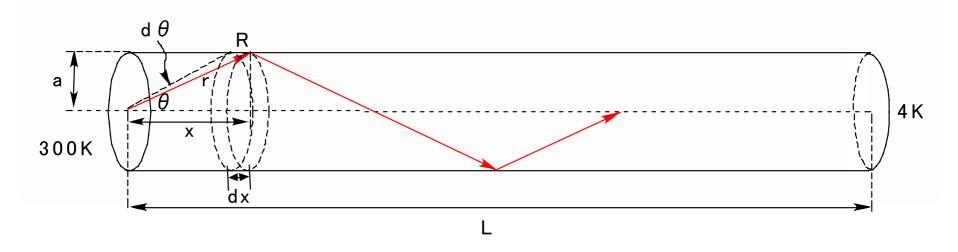


波長域数 μ m~100 μ m(ピーク~20 μ m) の赤外線と思って良い。

アルミの反射率スペクトラム



Ray TraceモデルによるCryo Pipe内の輻射伝搬の計算



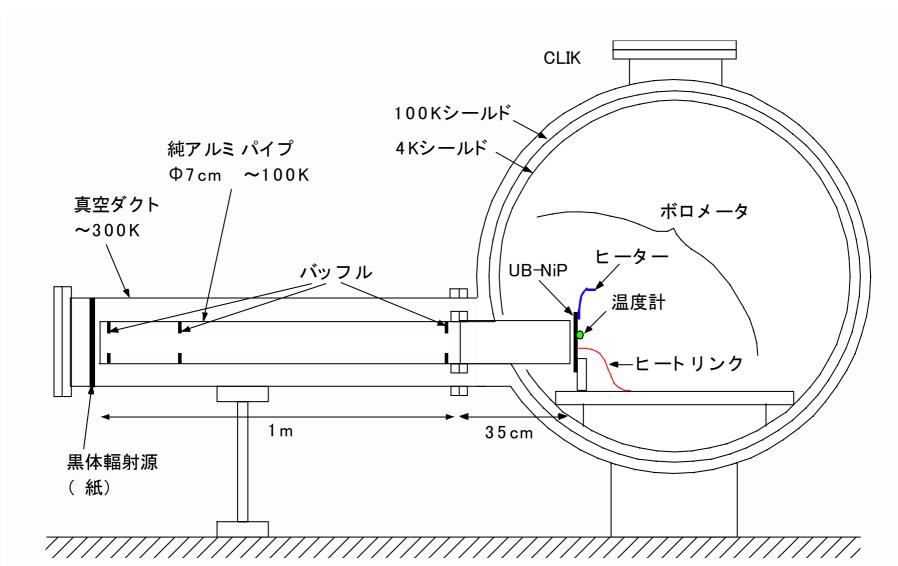
ダクト内の伝搬を考慮した時

	R = 0.90	R = 0.95	R = 0.97
$(P_{ref} + P_{th})/(P_{th})$	307	622	898
P_{ref}/P_0 の割合	14%	28%	40%

ダイレクト入射に比べ数100倍程度の輻射伝搬効果があり得る。

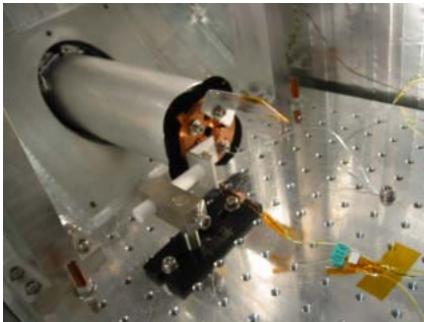
CLIKによる検証実験

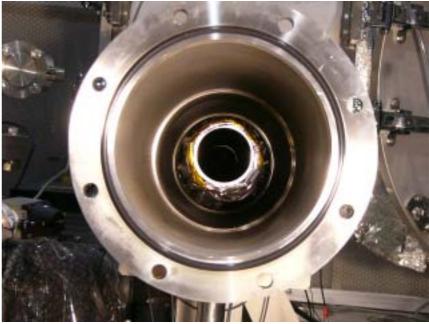
#ダクト部・バッフルのアスペクト比は大体CLIO・LCGTと同じ。











(1)300 K輻射による入熱量

(setup 1)

ボロメータの温度

1回目:14.13 K、2回目:14.28 K

2回の実験での平均入熱量:394 mW

ダイレクト入射熱量 :0.53 mW

UB-NiPの吸収率〜0.8 紙のemisivity~0.9と 1.1-

 \rightarrow P_{meas} / P_{direct} = 740倍

輻射伝搬効果を実験的に確認。

モデル計算から導かれた平均ダクト内面反射率は0.950。

→ 東理大赤外FELを用いたダクト内面の反射率とおよそ一致。

(2) 両端に1/3径のバッフルを入れた場合(CLIOに対応)

(setup 2) ボロメータの温度

1回目:18.3 K、2回目:19.4 K

2回の平均入熱量 : 7.9 mW

→ 低減率:98%(~1/50)

CLIOの方がこれより入熱は大きいが、 オーダーは一致。

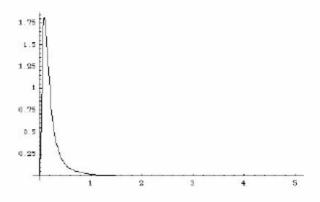
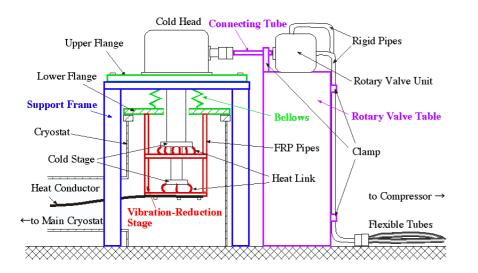


図 4: 式 3 の被積分関数をブロットしたもの。横軸は 300 K 開口部からの距離 (m)。

2. ヒートリンク部の接触熱抵抗の低減

CLIO用超低振動冷凍機システム開発に成功

→ さらなる高性能化のためにはヒートリンクの接触部 の抵抗を低減し、伝熱性能を向上させることが重要。





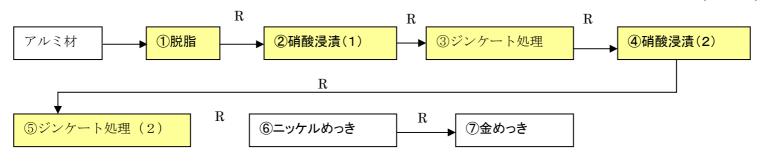
ヒートリンクには非常に柔らかい純アルミ撚り線を開発。

アルミの課題:

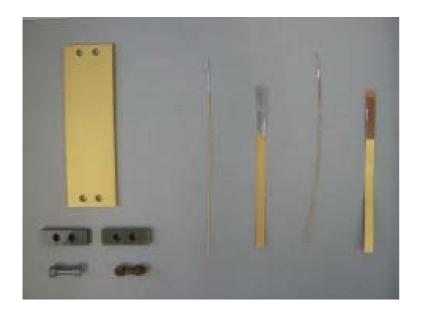
表面の強固な酸化皮膜のため接触抵抗が大きく出る。

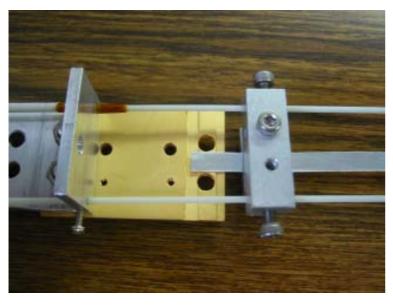
接触抵抗低減の一案 → アルミ表面の金メッキ処理による安定化 + 圧着

R. M. Muller et al. RSI 49 (1978) 515.

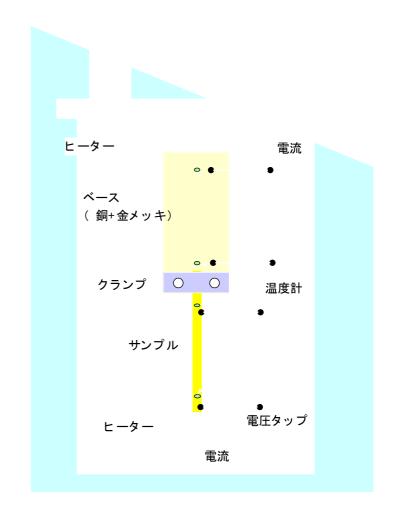


製作したサンプル





セットアップ



電気抵抗計測時の発熱が大きく、セットアップを改良して再計測準備中

まとめと今後の課題

1. CLIOクライオスタットの入熱解析

- 輻射伝搬効果による入熱を確認
- ・バッフルによる輻射伝搬率の低減を確認

今後の課題

より効率的なバッフルの設計と配置

2. ヒートリンク部の接触熱抵抗の低減

・金メッキ処理によるアルミヒートリンクの接触熱抵抗の計測 実験を推進中。年度内には計測終了予定。

今後の課題

アルミ撚り線ヒートリンク実機の製作・試験